
光固化3D打印抗撕裂弹性体研究获进展

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/37508.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

光固化3D打印抗撕裂弹性体研究获进展

。材料的抗撕裂性能与综合力学特性，是拓展光固化3D打印技术在传感、机器人及防护等领域应用的关键。

近日，中国科学院福建物质结构研究所研究团队，发挥自主研发的线扫描光固化3D打印（LSVP）系统对高黏度光敏树脂的加工优势，针对传统光固化弹性体因交联与缠结矛盾导致抗撕裂性能不足的问题，并通过链缠结—动态物理交联协同策略，开发出兼具优异抗撕裂性、自修复性与可回收性的光固化3D打印弹性体，推动光固化3D打印技术在柔性器件、智能材料等领域的应用拓展。

团队采用在甲基丙烯酸-2-(叔丁基氨基)乙酯封端的聚氨酯丙烯酸酯预聚物上接枝脲基嘧啶酮（UPy）基团的策略，通过调控氢键密度优化交联网络，构建无单体光固化树脂体系。该体系结合光热双重固化技术与多重氢键作用，形成兼具高密度链缠结与动态物理交联的拓扑网络，实现了链缠绕与物理交联的协同增效。团队进一步利用LSVP技术解决高黏度树脂打印难题，最大程度避免了活性稀释剂对材料性能的削弱，制备出高缠绕、弱交联的3D打印弹性体。

性能测试表明，UPyA-0.10弹性体展现出优异的综合力学性能，即拉伸强度超40 MPa，断裂伸长率约为1000%，韧性达144 MJ m⁻³

以上，其回弹性、抗撕裂性和延展性均达到热塑型制件水平。该材料具有出色的缺口撕裂抗性和缺口疲劳性能，断裂能达189.42 kJ m⁻²，打印结构可承受近9.8 kg拉伸载荷且无裂纹扩展，具备良好的自修复能力，经多次切割与再加工后仍保持稳定力学性能，展现出优异的可再加工性。

该工作突破了传统光固化弹性体抗撕裂性能的瓶颈，为高性能光固化3D打印弹性体的设计与制备提供了新思路，在柔性器件、结构防护、医疗器械等领域具有应用前景。

相关研究成果发表在Materials Today上。

研究团队单位：福建物质结构研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](http://www.iikx.com)转发